深圳市发展和改革委员会2024年第二批

战略性新兴产业专项资金项目申报指南

（半导体与集成电路产业集群）

一、支持类别和重点领域

支持相关单位承担国家发展改革委组织实施的专项。项目配套重点支持人工智能、新能源汽车、移动通信、北斗定位及卫星互联网、光电子、智能电网、超高清视频显示等领域芯片设计，硅基集成电路制造，化合物半导体制造，高端电子元器件制造，晶圆级封装、三维封装、芯粒等先进封装测试领域，适用于先进制程的薄膜生长、刻蚀、离子注入、量测等设备，以及适用于第三代半导体的特殊工艺设备。

二、扶持计划

**（一）国家项目配套扶持计划**

**1.政策依据**

深圳市发展和改革委员会关于印发《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2023-2025年）》的通知（深发改〔2023〕806号）

**2.扶持方向**

重点支持人工智能、新能源汽车、移动通信、北斗定位及卫星互联网、光电子、智能电网、超高清视频显示等领域芯片设计，硅基集成电路制造，化合物半导体制造，高端电子元器件制造，晶圆级封装、三维封装、芯粒等先进封装测试领域，适用于先进制程的薄膜生长、刻蚀、离子注入、量测等设备，以及适用于第三代半导体的特殊工艺设备。

**3.扶持方式及资助金额**

有关单位承担国家发展改革委开展的集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划，给予不超过1:1的资金配套，按照项目建设进度拨付，本市配套资金和国家资助资金加总不超过项目资金总额的一半。项目资助金额分阶段拨付，在项目扶持计划通知下达、项目完成40%的总投资额、项目通过验收三个阶段，分别按资助金额的40%、30%、30%分阶段予以拨付。

**4.申报要求**

（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。

（2）项目单位应为具备独立法人资格的企业、事业单位、社会团体或民办非企业等机构，拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。

（3）申报项目已获得国家发展改革部门批复同意立项，且申报时处于在建状态。

（4）对于已享受我市市级产业政策支持的项目，不得重复申报本次指南的资助支持。